



## 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年8月13日

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス

上場取引所 東

コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 文 TEL 03-3281-8186

四半期報告書提出予定日 2021年8月13日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無

四半期決算説明会開催の有無： 無

(百万円未満切捨)

### 1. 2022年3月期第1四半期の連結業績 (2021年4月1日～2021年6月30日)

#### (1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年3月期第1四半期	27,659	34.8	4,817	208.7	6,508	—	9,078	—
2021年3月期第1四半期	20,526	△2.3	1,560	△25.5	563	△68.5	△1,096	—

(注) 包括利益 2022年3月期第1四半期 13,183百万円 (—%) 2021年3月期第1四半期 △2,325百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2022年3月期第1四半期	243.85	219.84
2021年3月期第1四半期	△29.55	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2022年3月期第1四半期	208,935	105,722	40.8	2,288.12
2021年3月期	177,189	78,239	37.9	1,803.03

(参考) 自己資本 2022年3月期第1四半期 85,254百万円 2021年3月期 67,093百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2021年3月期	—	12.00	—	18.00	30.00
2022年3月期	—				
2022年3月期 (予想)		23.00	—	23.00	46.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

2021年3月期期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 記念配当 4円00銭

2022年3月期 (予想) 第2四半期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭

2022年3月期 (予想) 期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭

3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	58,000	39.4	10,000	155.6	12,000	324.8	16,000	—	427.70
通期	115,000	25.9	20,000	107.5	20,000	143.1	20,000	141.5	534.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー社（社名）ー、除外 ー社（社名）ー

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2022年3月期1Q	37,353,102株	2021年3月期	37,305,202株
② 期末自己株式数	2022年3月期1Q	93,568株	2021年3月期	93,568株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2022年3月期1Q	37,230,069株	2021年3月期1Q	37,116,134株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における経済状況は、米国経済では、政府が景気対策として財政出動を継続しており、また、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進み感染者数が減少し、経済活動は徐々に正常化に向かっています。中国経済は、同新型コロナウイルス感染症が収束し経済活動が正常化され、景気は上向いております。我国では、度重なる緊急事態宣言等の発出により、商業活動等に影響が出ているため、不透明な経済状況です。為替相場は、やや円安方向で推移しました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、世界的な外出規制によるリモートワークの浸透やWEB会議システムの普及拡大に伴い、パソコンやデータセンター用サーバーなどの需要が増加したため、メモリなど半導体の需要が旺盛で一部では品不足となり、デバイスメーカー各社は設備投資を前倒しし、保有する製造設備の稼働率も高水準となりました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、製造装置向けの真空部品や半導体製造プロセスに使用される各種マテリアル製品（石英・セラミックス等）の販売は堅調に推移し前年を上回りました。

電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、自動車温調シート向けは一定水準で推移し、5G通信システム機器向けの販売は好調でした。PCR検査装置などの医療検査機器向けのほか民生分野も堅調に推移しました。また、パワー半導体用基板は、新製品であるAMB基板の採用が増えたことから、売上は前年比で大きく伸長しました。

尚、中国で展開している半導体ウエハ製造会社の設備投資のため、同社株式を現地の投資基金等へ2回目の第三者割当増資を行った結果、持分変動利益(特別利益)が発生しております。また、韓国子会社1社の事業継続を取り止めることを決定したことにより、事業撤退損(特別損失)が発生しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は27,659百万円（前年同期比34.8%増）、営業利益は4,817百万円（前年同期比208.7%増）、経常利益は6,508百万円（前年同期比1,055.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は9,078百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,096百万円）となりました。

当第1四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

#### (半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

世界的なリモートワークの拡大に伴いスマートフォンやパソコン、サーバー等の需要増加により、電子部品の需給はひっ迫しております。半導体デバイスメーカー各社は、前倒しで設備投資を行う計画を発表しており、各種半導体製造装置メーカーからの受注も好調でした。

当社グループが供給する半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英・セラミックス等）の販売は、デバイスメーカーの稼働率が高水準であることから堅調に推移し、前年を上回る水準となりました。また、半導体製造装置などの部品洗浄サービスも需要増加により順調に受注を伸ばしました。この洗浄サービスを行う中国子会社は、中国の創業板市場へ上場申請を致しました。（2021年6月29日付開示「中国子会社の深セン証券取引所創業板市場への上場申請に関するお知らせ」をご参照ください。）

この結果、当該事業の売上高は16,959百万円（前年同期比22.1%増）、営業利益は3,132百万円（前年同期比325.1%増）となりました。

#### (電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

主力のサーモモジュールは、自動車温調シート向けが世界各国の自動車販売の回復により、一定の水準で推移しました。5G用の移動通信システム機器向けやPCR等の医療検査装置向けは共に好調な販売でした。民生分野向け、半導体装置向けは計画を上回る水準で推移致しました。

パワー半導体用基板は、IGBT向けDCB基板は、新型コロナウイルス感染症の影響から抜出し、回復基調となり、車載向けのAMB基板は、量産が進み前年比で伸長いたしました。磁性流体は、スピーカー向けとスマートフォン用途は一定水準で推移しました。

当該事業の各製品は、景気に左右されにくい業種への販売を進めております。

この結果、当該事業の売上高は5,502百万円（前年同期比58.7%増）、営業利益は1,539百万円（前年同期比74.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ31,745百万円増加し、208,935百万円となりました。これは主に現金及び預金7,695百万円、有形固定資産8,419百万円及び関係会社株式6,148百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ4,262百万円増加し、103,212百万円となりました。これは主に長期借入金1,330百万円が減少した一方、支払手形及び買掛金2,730百万円、その他流動負債1,767百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ27,483百万円増加し、105,722百万円となりました。これは主に資本剰余金6,339百万円、利益剰余金8,408百万円、非支配株主持分9,338百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年7月15日の「特別利益の計上見込み並びに業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「連結業績予想および配当予想の修正（特別配当）に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	30,202,819	37,898,359
受取手形及び売掛金	32,201,188	—
受取手形、売掛金及び契約資産	—	35,409,779
商品及び製品	5,381,026	5,497,124
仕掛品	5,064,821	5,684,451
原材料及び貯蔵品	6,680,313	8,245,399
その他	9,190,888	13,191,340
貸倒引当金	△643,491	△663,390
流動資産合計	88,077,566	105,263,064
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	15,446,974	16,467,742
機械装置及び運搬具（純額）	14,963,909	16,181,845
工具、器具及び備品（純額）	4,693,247	4,731,651
土地	1,893,760	1,895,071
リース資産（純額）	3,324,427	3,422,325
建設仮勘定	12,720,925	18,763,671
有形固定資産合計	53,043,245	61,462,307
無形固定資産		
のれん	576,285	546,634
その他	1,238,014	1,273,616
無形固定資産合計	1,814,299	1,820,251
投資その他の資産		
関係会社株式	23,317,126	29,465,750
その他	11,520,121	11,539,369
貸倒引当金	△582,712	△615,527
投資その他の資産合計	34,254,535	40,389,592
固定資産合計	89,112,080	103,672,151
資産合計	177,189,647	208,935,215

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,269,659	22,999,676
短期借入金	5,426,689	5,507,503
1年内償還予定の社債	5,468,000	5,468,000
1年内返済予定の長期借入金	6,513,161	6,499,427
未払法人税等	1,289,763	1,449,234
賞与引当金	990,470	1,084,142
その他	18,932,476	20,700,472
流動負債合計	58,890,220	63,708,456
固定負債		
社債	11,464,000	11,239,000
転換社債型新株予約権付社債	3,734,976	3,734,976
長期借入金	15,023,494	13,693,172
退職給付に係る負債	536,832	533,317
役員退職慰労引当金	18,300	—
資産除去債務	140,533	140,771
その他	9,141,594	10,162,823
固定負債合計	40,059,730	39,504,061
負債合計	98,949,950	103,212,518
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	17,702,650	17,737,042
資本剰余金	27,571,266	33,910,946
利益剰余金	18,221,662	26,630,460
自己株式	△86,644	△86,644
株主資本合計	63,408,935	78,191,806
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	318,207	310,400
繰延ヘッジ損益	△8,485	—
為替換算調整勘定	3,456,373	6,823,793
退職給付に係る調整累計額	△81,237	△71,712
その他の包括利益累計額合計	3,684,857	7,062,481
新株予約権	81,458	65,267
非支配株主持分	11,064,445	20,403,142
純資産合計	78,239,696	105,722,697
負債純資産合計	177,189,647	208,935,215

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
売上高	20,526,102	27,659,422
売上原価	13,730,882	17,290,593
売上総利益	6,795,219	10,368,828
販売費及び一般管理費	5,234,716	5,551,465
営業利益	1,560,502	4,817,362
営業外収益		
受取利息	12,545	103,864
補助金収入	159,312	152,520
持分法による投資利益	181,922	226,683
為替差益	—	1,411,659
その他	43,801	46,012
営業外収益合計	397,581	1,940,740
営業外費用		
支払利息	398,408	184,411
為替差損	900,050	—
その他	96,425	65,568
営業外費用合計	1,394,884	249,980
経常利益	563,200	6,508,122
特別利益		
固定資産売却益	—	12,023
持分変動利益	—	5,320,351
特別利益合計	—	5,332,375
特別損失		
固定資産処分損	—	67,784
減損損失	1,094,138	—
事業撤退損	—	921,839
その他	—	106,520
特別損失合計	1,094,138	1,096,144
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△530,938	10,744,353
法人税等	549,634	1,600,853
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△1,080,572	9,143,499
非支配株主に帰属する四半期純利益	16,039	64,892
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△1,096,611	9,078,607



(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△1,080,572	9,143,499
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	57,582	△5,002
為替換算調整勘定	△1,292,674	2,767,052
退職給付に係る調整額	5,999	4,819
持分法適用会社に対する持分相当額	△15,565	1,272,701
その他の包括利益合計	△1,244,657	4,039,570
四半期包括利益	△2,325,229	13,183,070
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△2,305,463	12,456,231
非支配株主に係る四半期包括利益	△19,766	726,839

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第1四半期連結累計期間において、連結子会社である江蘇富樂徳半導体科技有限公司及び寧夏富樂徳石英材料有限公司が第三者割当増資を実施したため、資本剰余金が6,186,428千円増加しました。

この結果、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が33,910,946千円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の場合には、出荷時に収益を認識しております。また、国外の販売については、履行義務は主に運送人引き渡し時点で充足されるため、当該時点において収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」を含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	13,887,964	3,467,903	17,355,868	3,170,233	20,526,102	—	20,526,102
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	10,567	—	10,567	174,303	184,871	△184,871	—
計	13,898,532	3,467,903	17,366,435	3,344,537	20,710,973	△184,871	20,526,102
セグメント利益	736,952	883,620	1,620,573	282,210	1,902,783	△342,280	1,560,502

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△342,280千円には、セグメント間取引の消去328,281千円、各報告セグメントに配分していない全社費用13,999千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「その他」セグメントにおいて1,094,138千円の減損損失を計上しております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	16,959,353	5,502,179	22,461,532	5,197,889	27,659,422	—	27,659,422
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	16,959,353	5,502,179	22,461,532	5,197,889	27,659,422	—	27,659,422
セグメント利益	3,132,724	1,539,541	4,672,266	199,554	4,871,820	△54,457	4,817,362

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△54,457千円には、セグメント間取引の消去△33,291千円、各報告セグメントに配分していない全社費用87,749千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「半導体等装置関連事業」セグメントにおいて、減損損失256,610千円を計上しており、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。

(重要な後発事象)

(持分法適用関連会社の第三者割当増資)

当社は、2021年5月11日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下、「CCMC」という。）が第三者割当増資を行うことを決議しましたが、2021年7月15日開催の取締役会において、当第三者割当増資の発行価額の総額を30億人民元から33億人民元とする決議をしました。なお、決議した発行価額の総額のうち、2021年6月30日までに1,720,929千人民元の払込みが完了し、残額については2021年8月31日までに払込みが完了する予定で現在交渉しております。

1. 増資の目的

12インチ半導体ウエーハの更なる生産能力増強

なお、本件後、当社グループのCCMCへの出資比率は現在の25.7%から23.1%となる見込であり、引き続き当社の持分法適用関連会社となる予定です。

2. 当該関連会社の概要

関連会社の名称 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

事業内容 半導体ウエーハの製造、販売

3. 第三者割当増資の概要

①発行する株式の種類および数	普通株式 1,100,000千株（予定）
②発行価額	1株につき3.00人民元
③発行価額の総額	3,300,000千人民元（予定）
④払込期日	2021年5月25日～2021年8月31日（予定）
⑤割当先	浙江省財務開発有限責任公司他複数社

4. 当該事象の損益に与える影響

当第1四半期連結累計期間において持分変動利益を特別利益に53億円計上しておりますが、第2四半期連結会計期間において持分変動利益が特別利益に追加計上される見込です。2021年8月31日までの払込み予定額をもとに見積りした持分変動利益は約34億円となりますが、一部の引受先と交渉中のため不確定要素があることから、持分変動利益は変動する可能性があります。